技术创新需求调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业信息** | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | | 第三届中国创新挑战赛（上海）组委会 | | | 机构代码 | |  | |
| 区 域 | | |  | 联系人 | 唐旭东 | | 电话 | | 13917662089 |
| 行业领域 | | |  | | | 产业领域 | |  | |
| 经济规模 | | |  | | | 人员规模 | |  | |
| **需求信息** | | | | | | | | | |
| 技术需求情况说明 | 技术需  求类别 | | ☑技术研发（关键、核心技术）  □产品研发（产品升级、新产品研发）  □技术改造（设备、研发生产条件）  ☑技术配套（技术、产品等配套合作） | | | | | | |
| 技术  需求  简述 | | 与国内铜材厂展开高性能铜合金的开发，实现高性能铜合金的本土化，能够满足电子连接器技术市场需求。 | | | | | | |
|  | 技术  需求  详述 | | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）  项目背景：随着电子连接器全球市场需求的持续增长，特别是在新能源汽车连接器领域，对高性能铜合金的开发需求也在不断增加。在一些高压连接器中，往往需要考虑导电率，抗应力松弛性，耐腐蚀性，折弯性能等多方面因素；目前主要铜材基本从国外引进，一些特殊铜材还受到国外管控，周期较长。 需求内容：与国内铜材厂展开高性能铜合金的开发； 达到的效果：实现高性能铜合金的本土化，能够满足电子连接器技术市场需求。 | | | | | | |
| 现有  基础  情况 | | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等）  急需与铜材供应商展开技术合作，配合完成电子连接器用高性能合金的开发，希望建立合作平台(孵化基地)，需要政府提供支持。 | | | | | | |
| 产学研合作需求 | 需求  描述 | | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） | | | | | | |
| 合作  方式 | | □技术转让 □技术入股 ☑联合开发 □委托研发  □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 | | | | | | |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融  □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购  □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 ☑其他 无 | | | | | | | | |
| **管理信息** | | | | | | | | | |
| 同意公开  需求信息 | | ☑是 □否  □部分公开(说明） | | | | | | | |
| 同意接受  专家服务 | | ☑是  □否 | | | | | | | |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 | | ☑是  □否 | | | | | | | |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 | | □是，金额 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）  ☑否  法人代表： 年 月 日 | | | | | | | |